

TAD-G-SI-1C ist ein additionsvernetzender, nicht korrosiver thermisch leitfähiger, flüssiger 1 Komp. Silikonkleber. Er vulkanisiert bei erhöhter Temperatur über 100°C zu einer stabilen und elastischen Verbindung bei den meisten Oberflächen aus, ohne dass ein Primer erforderlich ist. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Er kann bis 260°C Dauerbetriebstemperatur eingesetzt werden und oxidiert ausgehärtet nicht Kupfer oder dessen Legierungen. Der Kleber ist beständig gegenüber Wasser, Säuren und Laugen sowie den meisten organischen Lösungsmitteln und ist besonders geeignet bei Applikationen in denen hohe Klebkraft und Präzision, schnelle Aushärtung und eine hohe Wärmeleitfähigkeit erforderlich sind.

**EIGENSCHAFTEN**

- Wärmeleitfähigkeit: 1,38 W/mK
- Hohe Dauerklebkraft
- Additionsvernetzend bei Wärme
- Nicht korrosiv
- Hoher Betriebstemperaturbereich bis 260°C
- Extrem alterungs-/chemisch beständig

LIEFERFORMEN

- 1 kg Dose
- Andere Behälter auf Anfrage
- Optional mit Glaskugeln

ANWENDUNGSBEISPIELE

- LED Systeme
- Prozessorkühlung
- Speicherbausteinkühlung
- CPU Boards

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TAD-G-SI-1C
MATERIAL		
Farbe		Grau
Spezifische Dichte	g/cm ³	2,06
Lineare Schrumpfung	%	2,0
Viskosität	Pas	43
Härte	Shore A	67
Zugfestigkeit	MPa	3,1
Bruchdehnung	%	70
Aushärtung (@ 100°C)	min	30
Haltbarkeit (ab Herstellungsdatum, ungeöffnet @ < 15°C)	Monate	6
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	HB (1,5 mm)
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja
THERMISCH		
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	1,38
Ausdehnungskoeffizient Volumetrisch	x 10 ⁻⁴ /K	562
Ausdehnungskoeffizient Linear	x 10 ⁻⁴ /K	187
Betriebstemperaturbereich	°C	- 50 bis + 260
ELEKTRISCH		
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	22,5
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	7,7 x 10 ¹⁵
Oberflächenwiderstand	Ohm - cm	1,3 x 10 ¹⁵

Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.